

# 深圳市龙图光罩股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	方正证券、长城证券、华泰资管、中原证券、创世资本、蓝海基金、聚众鑫创投、沐德资产、必达资本、初华资本、亚威投资、杉树资产、敦汇资本
时间	2026年1月27日星期二上午10:00
地点	深圳市龙图光罩股份有限公司会议室（四）
上市公司接待人员姓名	1、证券事务代表：李建东 2、证券法务专员：丁子善
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模板厂商，主营业务为半导体掩模板的研发、生产和销售。</p> <p>自2024年8月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模板工艺能力从130nm逐步提升至65nm，并已完成40nm工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理IC等成熟制程，以及功率器件、MEMS传感器、先进封装等特色工艺制程。公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域持续加大研发投入，逐步实现高端制程的国产化配套，成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。</p> <p><b>二、投资者互动交流</b></p> <p><b>1、公司珠海募投工厂当前产能释放进度、核心产品进展及后续规划如何？</b></p> <p>回复：公司珠海高端半导体芯片掩模版制造基地于2025年上半年顺利投产，目前处于产能爬坡关键期。核心产品方面，KrF-PSM和ArF-PSM陆续送往部分客</p>

户进行测试验证，其中 90nm 节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 产品已开始送样验证，已完成 40nm 生产设备布局。后续将加速珠海工厂产能释放，重点提升高端产品供给能力，匹配下游国产替代需求。

## **2、珠海工厂二期工程进展及是否存在融资规划？**

回复：珠海二期工程按计划顺利推进，主体厂房已于 2025 年 9 月完成封顶，该项目是公司突破高端制程、扩大产能的战略性布局，将补充高端制程及新兴应用领域产能。目前公司资产负债率处于较低水平，未来将考虑通过债权、股权融资等方式筹集项目资金，具体方案将结合资本市场环境、监管政策及公司财务状况审慎决策，严格履行信息披露义务。

## **3、公司产品认证流程及周期，不同制程认证难度差异如何？**

回复：认证流程主要包括签订 NDA 协议、信息安全体系评估、制版能力及精度指标考察、工艺与测量方式匹配验证、数据处理确认、样品评估及流片测试等环节。整体认证周期通常 6-12 个月甚至更长，制程等级越高，认证越严格、周期越长。目前公司 90nm 产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 产品处于客户验证阶段。

## **4、目前国内的石英基板不能满足高端光罩的生产吗？**

回复：目前国内高纯石英基板在满足高端光罩要求上，主要指标差距体现在材料纯度、缺陷密度、表面平坦度及热膨胀系数稳定性等方面，这些直接影响光罩的精度与良率，差距根源在于高纯度合成与超精密加工等核心技术积累。我们乐见并支持国内高端基板技术的突破，在相关产品能够持续满足工艺稳定性与良率要求的前提下，公司将积极稳妥地推进合格国产基板的验证与导入工作。

## **5、产品毛利率水平及变动原因，未来毛利率走势如何？**

回复：公司 2025 年上半年毛利率有所下降，系 130nm 及以上制程的光罩产品竞争加剧，公司采取阶段性降价策略所致。未来随着珠海工厂高端产品验证通过及量产，高端产品占比提升将带动毛利率修复，同时规模效应也将进一步优化成本结构。

## **6、目前中日关系是否对于公司进口原材料如石英**

	<p><b>基板等产生影响呢？</b></p> <p>回复：关于中日关系对原材料进口的影响，公司目前生产经营活动正常，在现有产品所涵盖的制程节点范围内，相关原材料的采购与进口暂未受到进出口管制的实质性限制。公司深知供应链安全的重要性，并已采取积极措施应对，包括建立国产供应商验证体系，在石英基板等关键材料上推动国产替代，以优化供应链结构，降低潜在风险。</p>
	<p><b>7、公司目前在半导体掩模版行业的竞争格局中处于什么位置？与海外头部厂商相比，核心优势和差距分别在哪里？</b></p> <p>回复：全球半导体掩模版市场中，日本凸版、美国 Photronics、日本 DNP 三家，合计占据超过 80%以上的份额。公司作为国内独立第三方厂商，聚焦半导体掩模版领域，目前主力产品覆盖 130nm 及以上制程，核心应用于功率半导体、模拟 IC 领域，主要优势在于响应速度快、服务能力强；差距主要体现在先进制程（28nm 及以下）研发与量产能力，以及全球客户资源布局上，海外头部厂商已实现 EUV 掩模版量产，技术水平上仍存在一定的差距。</p>
	<p><b>8、珠海工厂计划生产 PSM 掩模产品，这个和普通的二元掩模有什么区别？</b></p> <p>回复：PSM（相移掩模版）与普通 BIM（二元掩模版）的核心区别在于其提升光刻分辨率的技术原理。BIM 仅通过透光（亮区）与不透光（暗区）的二元结构来转移图形，其物理极限在相对高端的制程中会导致图形边缘光学干扰，影响精度。而 PSM 通过在相邻透光区域引入 180 度的相位差，利用光的干涉效应使中间暗区的光强抵消得更彻底，从而显著提升成像的对比度和分辨率，尤其适用于线宽更小、密度更高的高端芯片制造。因此，PSM 是支撑 90nm 及以下更先进制程的关键技术，其设计和制造复杂度远高于 BIM。公司在此领域已具备成熟的技术积累和量产能力，能够满足客户对高端节点的需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 27 日星期二